

合肥顾中科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-011

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演/反路演活动 ☒现场参加 ☒电话会议 ☐其他（请文字说明其他活动内容）
来访单位名称	中泰证券、财通证券、国泰海通证券、中信证券、申万宏源、国信证券、华富基金、醇厚基金、圆信永丰基金、申万菱信基金、中庚基金、兴全基金、浦银安盛基金、上银基金、西部利得基金、华宝基金、平安养老基金、山西资管、上海自营、永赢基金、牧鑫资产、农银汇理基金等
时间	2025 年 11 月 7 日
上市公司接待人员姓名	总经理：杨宗铭 副总经理、董事会秘书、财务总监：余成强
投资者关系活动主要内容介绍	1. 问：公司非显示驱动芯片的主要业务是什么，应用在哪些领域？ 答：公司非显示类芯片封测以电源管理芯片、射频前端芯片（射频开关、滤波器、功率放大器（PA）、低噪放（LNA）、双工器等）、功率器件为主，少部分为 MCU（微控制单元）、MEMS（微机电系统）等其他类型芯片，可广泛用于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游应用领域。 2. 问：境内和境外客户结构的占比？ 答：2025 年第三季度，公司内销收入占比约 74%，外销收入占比约 26%。 3. 问：公司非显示业务的竞争优势？ 答：依托在显示驱动芯片封测领域多年来的耕耘以及对凸块制造技术的积累，公司于 2015 年将业务拓展至非显示类芯片封测市场，目前该领域已日渐成为公司业务重要的组成部分以及未来重点发展的板块。公司现可为客户提供包括铜柱凸块（Cu Pillar）、铜镍金凸块（CuNiAu Bumping）、锡凸块（Sn Bumping）在内的多种高端金属凸块制造，同时大力发展基于砷化镓、氮化镓、钽酸锂等第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测

	业务，积极地布局“FSM（正面金属化）+BGBM（背面减薄与金属化）+Cu Clip（铜片夹扣键合）”的先进封装组合，建立载板覆晶封装（FC）制程，优化公司产品布局，拓宽功率芯片应用领域，提升公司非显示类封测业务全制程服务能力，带动现有制程的业务拓展。 4. 问：公司非显示业务的主要客户？ 答：公司非显示业务的主要客户有昂瑞微、矽力杰、杰华特、南芯半导体、纳芯微、艾为电子、唯捷创芯等 5. 问：公司 2025 年第三季度的经营情况如何？ 答：2025 年第三季度，公司实现营业收入 6.09 亿元，同比增长 21.42%，环比增长 16.76%；归母净利润 8,534.88 万元，同比增长 28.58%，环比增长 22.38%。 6. 问：2025 年第三季度，公司显示和非显示业务营收占比如何？ 答：2025 年第三季度，公司显示业务营收占比约 93%，非显示业务营收占比约 7%。 7. 问：公司本次可转债的募投项目完成后，预计能给公司带来多大的业绩提升？ 答：高脚数微尺寸凸块封装及测试项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出，预计项目完全达产后每年将实现销售收入为 35,587.54 万元。先进功率及倒装芯片封测技术改造项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出，预计项目完全达产后每年将实现销售收入为 34,583.81 万元。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 11 月 10 日